

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005年8月25日 (25.08.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/077633 A1

(51) 国際特許分類7: B29C 43/18, 33/68, H01L 21/56

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/019164

(22) 国際出願日: 2004年12月22日 (22.12.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-037179 2004年2月13日 (13.02.2004) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): TOWA 株式会社 (TOWA CORPORATION) [JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地 Kyoto (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 高瀬慎二

(TAKASE, Shinji) [JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地 TOWA 株式会社内 Kyoto (JP). 田村孝司 (TAMURA, Takashi) [JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地 TOWA 株式会社内 Kyoto (JP). 大西洋平 (ONISHI, Yohei) [JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地 TOWA 株式会社内 Kyoto (JP).

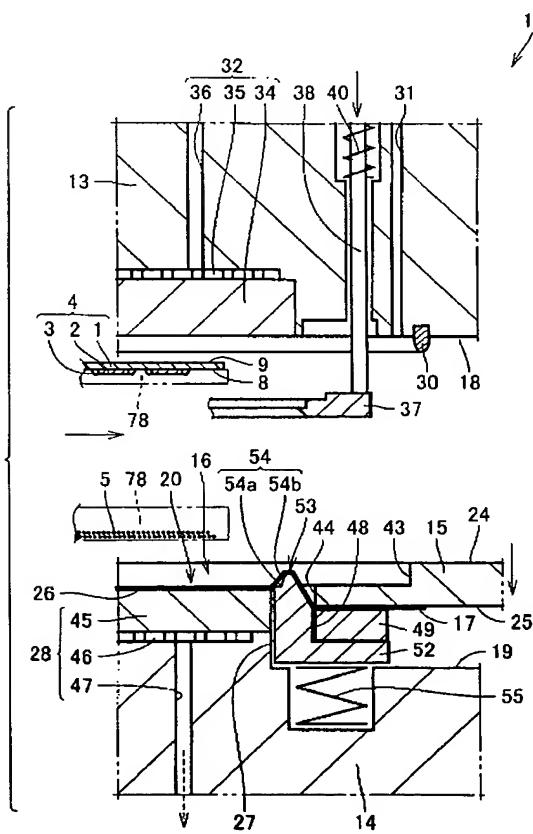
(74) 代理人: 深見久郎, 外 (FUKAMI, Hisao et al.); 〒5300054 大阪府大阪市北区南森町2丁目1番29号 三井住友銀行南森町ビル 深見特許事務所 Osaka (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, IU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

[続葉有]

(54) Title: RESIN SEALING METHOD FOR ELECTRONIC PART AND MOLD USED FOR THE METHOD

(54) 発明の名称: 電子部品の樹脂封止方法およびそれに用いられる金型



(57) Abstract: A resin sealing method for an electronic part (2) using a cope (13), a drag (14), an intermediate die (15), and a releasing film (17). The releasing film (17) is held by the drag (14) and the intermediate die (15), subjected to a specified tension, and covers the cavity (16) of the drag (14). In this case, the side face (54b) of the cavity is covered by the releasing film (17). Accordingly, the releasability of the side face (54b) of the cavity from a hard resin (10) is improved. As a result, the hard resin (10) can be prevented from being damaged near the side face (54b) of the cavity.

(57) 要約: 本発明の電子部品(2)の樹脂封止方法においては、上型(13)、下型(14)、中間型(15)、および離型フィルム(17)が用いられる。離型フィルム(17)は、下型(14)と中間型(15)とによって挟まれ、所定の張力がかけられ、下型(14)のキャビティ(16)を被覆する。このとき、キャビティ側面(54b)が離型フィルム(17)によって被覆される。そのため、キャビティ側面(54b)と硬化樹脂(10)との離型性が良好になる。その結果、キャビティ側面(54b)の近傍で硬化樹脂(10)が損傷することが防止される。

WO 2005/077633 A1



SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護
が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA,
SD, SI, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ヨーラシア (AM, AZ,
BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,
BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

添付公開書類:
— 國際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。